

“墙体保温与建筑节能”
2008年中国国际墙体保温材料及应用技术交流会

会议通知
(第一轮)

中国建筑科学研究院

中国建筑学会建筑材料分会
墙体保温材料及应用技术专业委员会

2008年3月

为了促进我国建筑墙体保温技术的交流，吸收国外墙体保温方面的先进技术和经验，提升我国建筑节能的整体水平，中国建筑学会建筑材料分会墙体保温材料及应用技术专业委员会与中国建筑科学研究院将于2008年10月15日—17日在杭州举办“墙体保温与建筑节能——2008年中国国际墙体保温材料及应用技术交流会”。会议将就墙体保温材料及其应用技术进行广泛的学术交流，并将邀请国内外著名专家作专题报告。同时，会议期间将举行小型展览会，将展出国内外相关知名企业和科研单位在墙体保温节能领域的新产品、新技术和新工艺。

一、会议主题

墙体保温与建筑节能

二、参会人员

会议将邀请建设行业主管部门、房地产开发商、建筑设计院、建筑施工企业、工程监理单位、质量检测机构、材料及系统供应商以及科研院所等单位的国内外代表参会。

三、会议征文

为提高技术交流效果，本次会议将编辑《墙体保温与建筑节能》论文集，并由国家级出版社正式出版发行。现开始征集论文，欢迎国内外相关领域的行业管理人员、科研人员、设计人员、工程技术人员、检测人员、院校师生等踊跃投稿。征文主要议题包括：

- 1、国内外建筑墙体保温材料及其应用技术的最新动态和发展趋势
- 2、适合不同区域的外墙保温系统研究（包括外保温、自保温、内保温及其他新型保温系统）
- 3、墙体保温系统的工程质量、安全性、耐久性及使用维护问题
- 4、国内外建筑墙体保温材料、施工工艺及典型工程案例
- 5、建筑墙体保温测试技术
- 6、既有建筑物墙体保温节能改造技术
- 7、国内外建筑墙体保温或建筑节能领域的相关标准规范、政策法规
- 8、国内外在墙体保温领域的重要学术或技术研究进展

9、建筑墙体保温装饰一体化技术

10、墙体保温系统的配套材料（包括配套的砂浆、锚固件等）

四、论文要求及注意事项

- (1) 要求提交的论文是未曾公开发表过的。
- (2) 论文排版纸型要求为 A4，版芯尺寸严格控制为 145mm~210mm（用 Word97 或其以上的版本排版，页边距上下各为 4.35cm，左右各为 3.25cm）。
- (3) 论文内容应包括论文题目、作者姓名及工作单位、摘要及关键词、论文正文、参考文献。论文题目、作者、单位、摘要及关键词须中英文对照。
- (4) 论文首页的题目上方空一行，论文题目用三号黑体字居中；论文题目与作者姓名之间空一行，作者姓名及工作单位用五号宋体居中；第一作者简介（性别、出生年月、职称、单位地址、邮政编码及详细联系电话）标注在论文首页版芯内左下方，用小五号宋体字，并在简介与正文之间划一黑实线（只需划一半）；摘要和关键词用小五号宋体，并与姓名及工作单位之间空一行。
- (5) 论文正文与摘要和关键词之间空一行；正文中的一级标题用四号黑体字居左，次标题用小四号黑体字居左，再次一级标题用五号黑体居左，论文正文用五号宋体字；行距要求：纯五号宋体字每页 36 行。
- (6) “参考文献”四个字用五号黑体字居左，并与论文正文之间空一行。参考文献内容采用小五号宋体字。
- (7) 文章篇幅宜控制在 4 页之内，如确有必要，则最多不超过 7 页。
- (8) 论文一经登载，文责自负。
- (9) 对于投稿论文，本论文集编委会将择优录用，或摘要录用，如未录用的论文，编委会将及时通知作者。
- (10) 请将论文通过 E-mail 以 Microsoft Word 附件形式发送至：qtbwcl_jzxx@163.com，邮件主题注明“会议投稿”。
- (11) 中英文投稿均可。

五、论文征集截止日期

论文摘要提交截止日期：2008年5月20日；摘要将由会议学术委员会预审，收到摘要后十日内通知作者是否录用。

论文全文提交截稿日期：2008年7月20日

六、联系方式：

联系地址：北京北三环东路30号，中国建筑科学研究院建材所，100013

会议组委会联系人：曹力强、郭向勇、艾明星、赵霄龙、李 军

电 话：010-64517955，64517776（赵），64517859（李），13910856510（曹）

传 真：010-84276512

E-mail：qtbwcl_jzxh@163.com

会议指定网址：<http://www.qtbaowen-asc.com>

提示：1、拟设参展内容：墙体保温材料（含配套材料）、制品及保温系统，墙体保温施工设备，检测仪器，典型工程案例展示等。欢迎国内外相关企业、科研院所积极洽谈参展事宜。

2、会议组委会后续将发出新一轮会议通知确定具体会址和会议日程等，敬请关注。

中国建筑科学研究院

中国建筑学会建筑材料分会

墙体保温材料及应用技术专业委员会

2008年3月